

車載半導体の安定調達に向けた取り組みに関する説明会

2025年8月27日

日本自動車工業会
日本自動車部品工業会

自工会・部工会事業活動にあたってのお願い

- 事業者団体の事業活動において、情報の収集・共有といった活動は場合により、**独占禁止法に抵触する可能性がある**ため、十分な注意が必要です。
- 委員会等の活動にあたっては、委員に就任した皆様は**独占禁止法**及び公正取引委員会が定めた**「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイドライン)**を遵守いただくよう、お願い致します。
- 詳しくは自工会の独占禁止法確認ページをご確認ください。

独占禁止法確認ページ

https://www.jama.or.jp/member_rule/index.html

【事例：一部抜粋】

1. (1) 価格について協議し、競争を阻害すること。

→ 業界団体の活動において、事業製品の価格に間接的にも関連するような議論や個社間の取引で協議するような費用・条件について、業界として収斂させるようなことはできない。



本日は質疑応答の時間を設けておりますが、上記独禁法をご留意の上、ご発言いただきますようお願い致します。

車載半導体の安定調達に向けた取り組みに関する説明会

| | | | | |
|-----|--|----------------------------|---------------|-----|
| 目的 | 自工会「7つの課題」の1つである「半導体の国際競争力確保」に向け、旧型品を長期使用するのではなく、旬な半導体を採用し新陳代謝することで、車載半導体の安定調達につなげる。 | | | |
| 主催 | 日本自動車工業会・日本自動車部品工業会の共催 | | | |
| 日程 | 2025年8月27日(水)13:00-14:00 | | | |
| 形式 | ZOOMウェビナー | | | |
| 参加者 | 半導体を調達している部工会会員企業(調達部門の方)、サプライチェーン全体へ展開するため、会員企業の関係グループ会社も参加可能とする | | | |
| 内容 | 自工会・部工会の半導体WGより、下記にて説明 | | | |
| | | 議題 | 説明者 | 時間 |
| | 1 | 自工会「7つの課題」と取り組みの背景 | 自工会 半導体WG | 5分 |
| | 2 | 新陳代謝の促進に向けた自工会ガイドライン | 自工会 半導体WG | 5分 |
| | 3 | 新陳代謝の促進に向けた部工会ガイドライン、業務フロー | 部工会 半導体WG | 5分 |
| | 4 | 車載半導体データPF | 自工会 半導体WG | 5分 |
| | 5 | 本日の依頼事項 | 自工会/部工会 半導体WG | 5分 |
| | 6 | 質疑応答 | 自工会/部工会 半導体WG | 35分 |
| | 計 | | 60分 | |
| その他 | 後日、アーカイブ配信を実施 ※当日説明資料もあわせて部工会ホームページへ掲載 | | | |

本日は上記の概要で説明会を実施いたします

自工会「7つの課題」と取り組みの背景
新陳代謝の促進に向けた自工会ガイドライン

自工会 半導体WG

■ 22年、以下の枠組みで、未来のモビリティ社会実現に向けた検討を開始

- ・**経団連モビリティ委員会**：自工会の活動を、関連業界のみなさまと一緒に拡大することで、モビリティ産業への進化を加速するとともに、政府との対話の窓口とする
- ・**官邸モビリティ懇談会**：省庁の壁を越え、総理へモビリティ産業の重要性・課題をご理解いただくことで、引き続き基幹産業として日本の競争力に貢献する

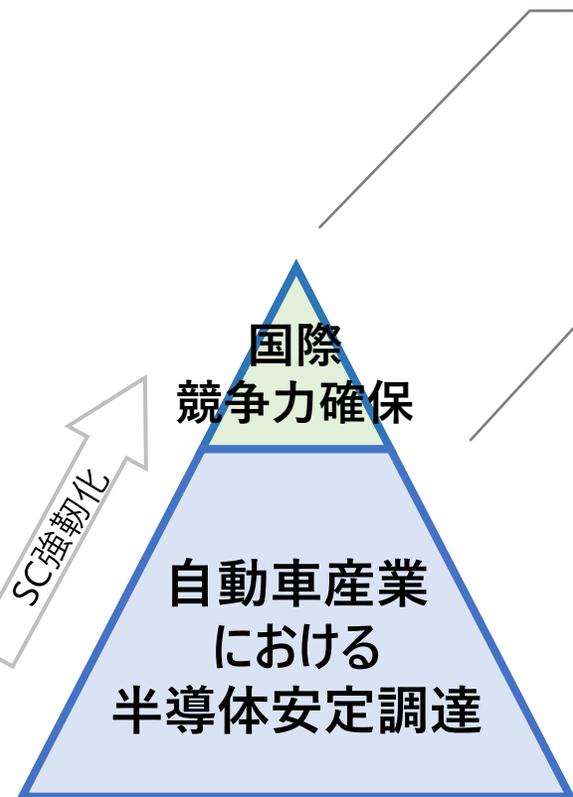
■ 23年、短期で取り組むべき優先課題として、「モビリティ産業 7 つの課題」を経団連・官邸と合意

… 自工会正副会長をリーダーとし、「民間でやれること」「政府の力を借りること」を明確にしなが、トップダウンで課題に対応

| | | |
|-----|-------------|-------------------------|
| 課題① | 片山会長 (いすゞ) | 物流・商用・移動の高付加価値化/効率化 |
| 課題② | 内田副会長 (日産) | 電動車普及のための社会基盤整備 |
| 課題③ | 三部副会長 (ホンダ) | 国産電池・半導体の国際競争力確保 |
| 課題④ | 佐藤副会長 (トヨタ) | 重要資源の安定調達/強靱な供給網の構築 |
| 課題⑤ | | 国内投資が不利にならない通商政策 |
| 課題⑥ | 鈴木副会長 (スズキ) | 競争力あるクリーンエネルギー |
| | 日高副会長 (ヤマハ) | |
| 課題⑦ | 日高副会長 (ヤマハ) | 業界を跨いだデータ連携や部品トレサビの基盤構築 |

特に課題が大きい
「レガシー半導体領域の半導体の
安定調達」を取り組みと決定

環境認識 : 1. 各国をめぐる**経済安保リスク** (US半導体規制・中国低価格品流入など) 2. 自然災害や地政学リスクを受けた**BCP対応ニーズ**の高まり
 ありたき姿 : 不確実な情勢の中**でも自動車産業が日本の基幹産業であり続けるために、産業のリスクを下げ、発展的な成長** (GX,DX含む) を支える環境を整備する



半導体メーカーの競争力確保への取り組み (官民連携による産業強化の枠組み)

民での取り組みに加え、国策と連動した取り組みにより、国内サプライチェーンの強靱化を官民で検討する

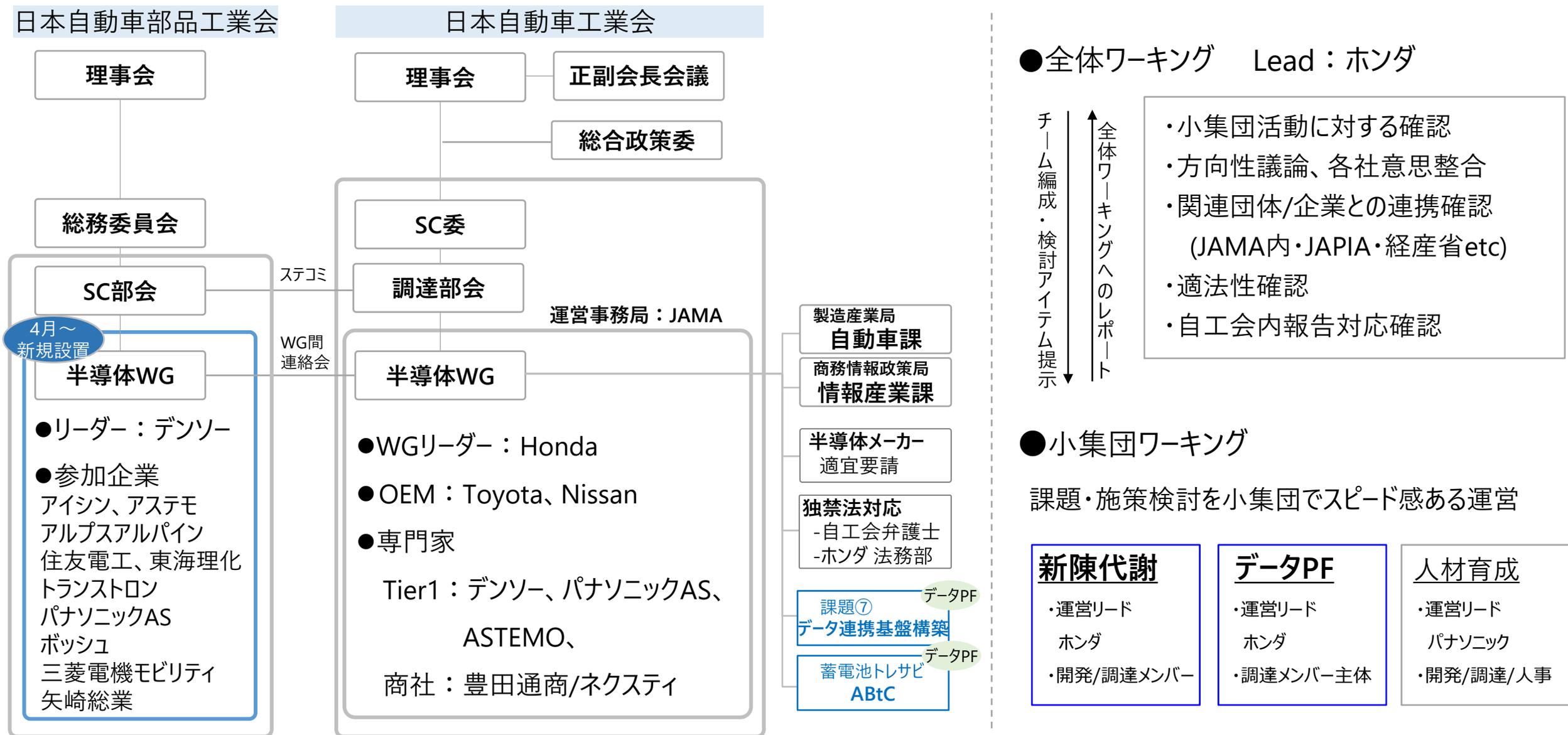
自工会 半導体WG 取り組み

過去に起きた**半導体不足**、**災害**(火災/地震etc)により、自動車産業各社が大きく事業を棄損
 この事象から**問題を紐解き、解決を目指していく**

| 起きたこと | 課題 | 業界横断で必要なこと |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 開発効率を追求し半導体を長期使用してきた中、古い半導体の生産が停止され供給寸断 <small>※半導体ベンダーにとっては古い半導体の生産維持が事業の足かせとなり競争力阻害要因となるケースあり</small> どこの何の半導体を使っているか把握ができず、有事対応の遅れによる事業影響の拡大 | <ul style="list-style-type: none"> 旬な半導体に切り替えていく 開発/調達のプロセス転換 旬な半導体製品のタイムリーな把握 半導体のサプライチェーン情報把握と事前のBCP備え | <ul style="list-style-type: none"> 古い世代の半導体の新陳代謝 半導体-自動車部品のECM/SCMを繋ぐ車載半導体情報基盤 |

安定調達を成し遂げる為、業界横断で古い世代の半導体新陳代謝と半導体情報基盤に取り組んでいる

2025年度 半導体WG体制



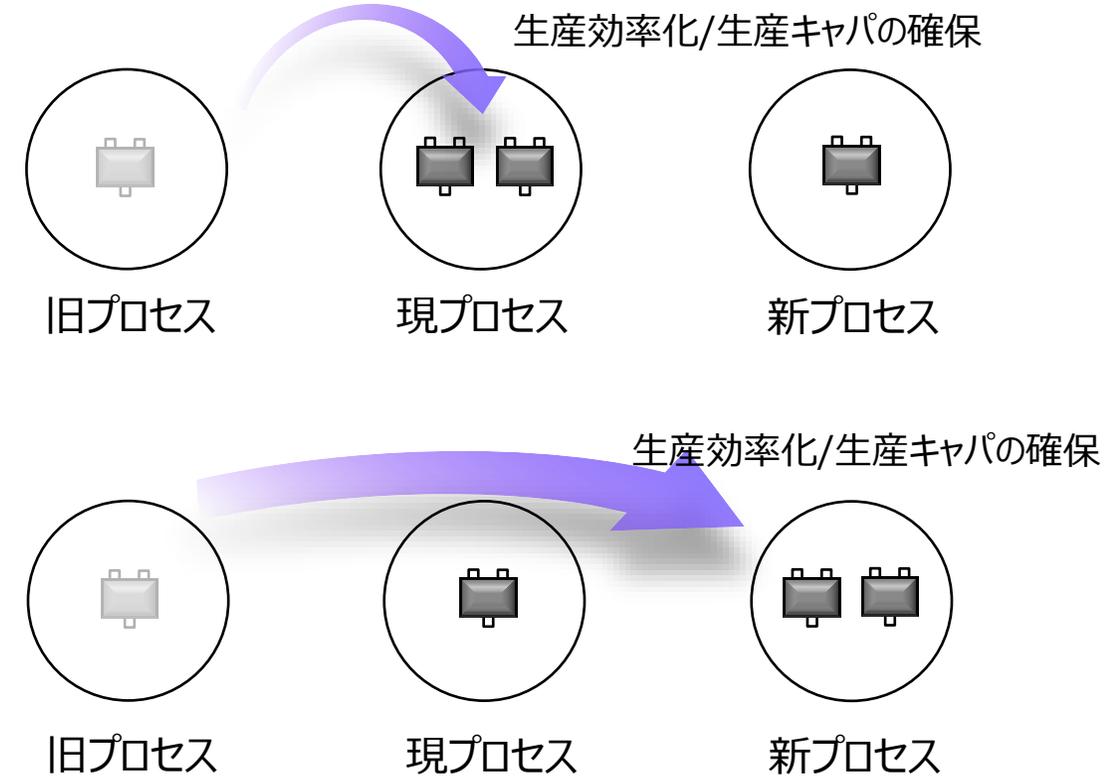
半導体活動の広い認知と展開を目指して今期より部工会様にも半導体WGを設定いただき、連携強化中

◆ コロナ禍における供給問題の深掘り

| カテゴリ | 問題事象 | 当時の供給対応 |
|--------|--|--|
| 電源IC | コロナからの市場回復に対するオーダーに生産が追従できず、後工程(PKG)歩留りと合わせてデコミ発生 | <ul style="list-style-type: none"> ・市中品での代用検討 ・生産納期のプルイン(納期前倒し)交渉 ・基板変更も含めた性能代替品検討 ・高歩留り工程への変更 |
| MCU | コロナからの市場回復に対するオーダーに生産が追従できず、後工程(検査)コロナ被災と合わせてデコミ発生 | <ul style="list-style-type: none"> ・検査工程歩留り改善 ・費用交渉 ・基板変更も含めた性能代替品検討 ・後工程能拡 |
| MCU | 需要減による生産縮小の計画であった工程にこれを超えるオーダーがあり追従できず | <ul style="list-style-type: none"> ・生産納期のプルイン(納期前倒し)交渉 ・基板変更も含めた性能代替品検討 |
| ドライバIC | 需要減による生産縮小の計画であった工程にこれを超えるオーダーと後工程(検査)設備故障による稼働率低下があり追従できず | <ul style="list-style-type: none"> ・生産納期のプルイン(納期前倒し)交渉 ・基板変更も含めた性能代替品検討 ・設備復旧対応 ・市中品での代用検討 |
| ドライバIC | 古いプロセスノードによるウェハ工程のため、能力を拡大できず、これを超えるオーダーに追従できず | <ul style="list-style-type: none"> ・基板変更も含めた性能代替品検討 |
| ASIC | コロナからの市場回復に対するオーダーに生産が追従できず、デコミ発生 | <ul style="list-style-type: none"> ・市中品での代用検討 ・生産納期のプルイン(納期前倒し)交渉 ・次世代チップの開発前倒し |

総じて、古いプロセス・古い製品の供給途絶が多く発生した

◆ 半導体標準化(チップ世代の標準化、新陳代謝)

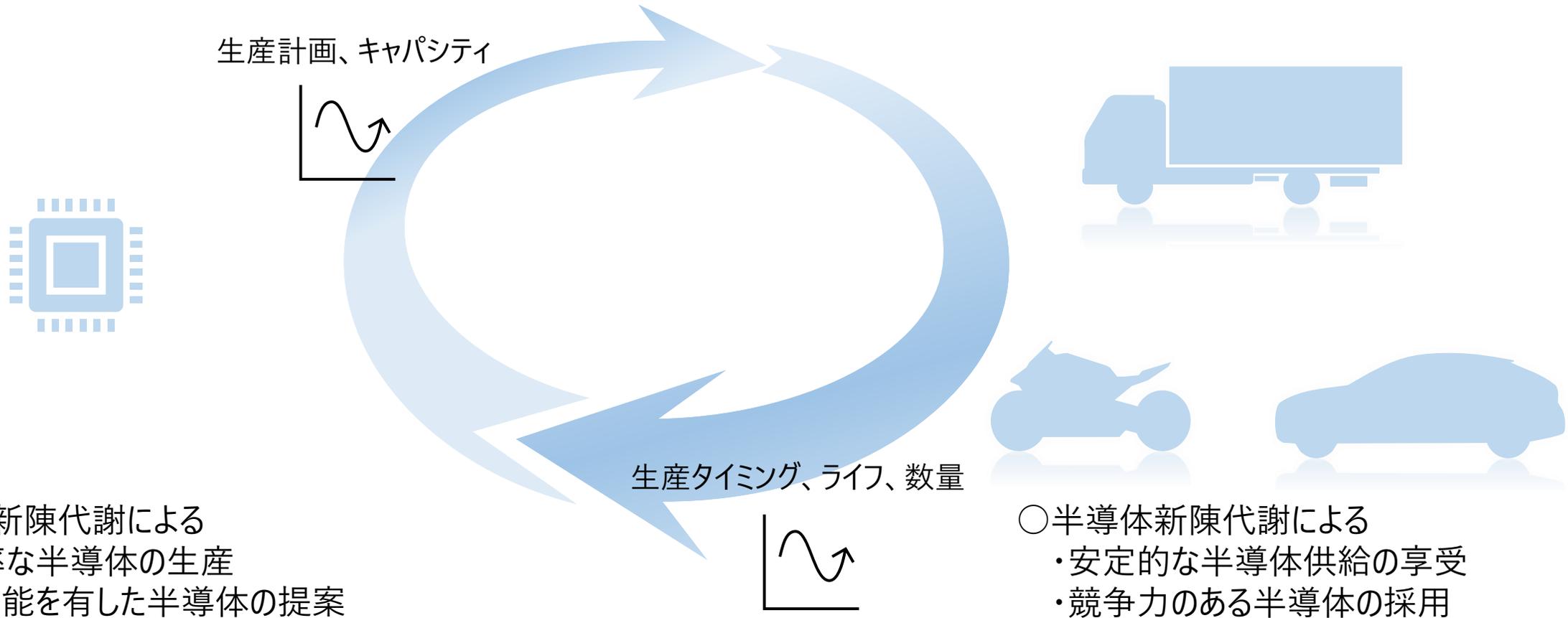


※旧プロセスは半導体サプライヤ様ごとに位置づけが異なる
 ※効果はベンダーごとの設備や流動状況で異なる

コロナ禍における供給問題の背景に旧世代チップを使い続ける潜在リスクを回避するため、旧世代チップの継続採用を極力回避することで供給体質と競争体質の向上を図るという結論に至った

半導体業界

自動車業界



車載半導体の生産計画はこれを採用する車両のライフと密接な関係があるため、これらの共有に努めることで効率の良い切替と新陳代謝による効率的な生産の両立を図りたい

～車載半導体の新陳代謝促進による供給安定性向上を目的としたガイドライン案～

[前文]OEMとTier1共に設計資産を最大活用することを前提としながら、将来の半導体や車載向け電子電装部品の安定調達性を向上させるため、自工会として車両計画共有に関するガイドラインを策定する

| ガイドライン | 努力目標 |
|---|---|
| <p>①【部品新規開発の場合】 電子電装部品の新規開発時において、Tier1にて供給性を確保した製品選定ができるように、RFQに必要な情報を明示する</p> <p>※なお、10年を超えるような長期車両、かつモデルチェンジなどのイベントの計画がない車両の場合は定期的に供給性を確認するマイルストーンを設ける</p> | <p>下記情報例の提示に努める</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 該当PJT(車両)の量産開始時期 b) 該当PJT(車両)の企画モデルライフ c) 該当PJT(車両)の企画台数 <p>※企画モデルライフは企画時の償却想定期間で、生産期間ではありません ※企画モデルライフと生産想定期間が異なる場合は別途通知を行う</p> |
| <p>②【部品流用の場合】 既存の電子電装部品の流用時において、各OEMで当該部品の車両展開情報を可能な限り正確に、かつ迅速に通知する</p> <p>※なお、10年を超えるような長期車両、かつモデルチェンジなどのイベントの計画がない車両の場合は定期的に供給性を確認するマイルストーンを設ける</p> <p>※提示方法についてはRFQに限らず個社運用に沿って対応</p> | <p>下記情報例の提示に努める</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 電子電装部品が展開される先の該当PJT(車両)の量産開始時期 b) 該当PJT(車両)の企画モデルライフ c) 該当PJT(車両)の企画台数 <p>※企画モデルライフは企画時の償却想定期間で、生産期間ではありません ※企画モデルライフと生産想定期間が異なる場合は別途通知を行う</p> |
| <p>③【車両生産延長の場合】 ①、②で提示した企画モデルライフよりも長期に生産する車両において、生産延長が判明した段階で迅速に通知する</p> | <p>下記情報例の提示に努める</p> <ul style="list-style-type: none"> ・EOP/モデルチェンジの時期情報 (EOP/モデルチェンジが未定の場合は、その旨通知) |
| <p>上記①～③を踏まえ、供給継続に懸念が発生する場合において、Tier1とOEMで密にコミュニケーションを取り、QCD等も考慮の上、対応については当事者間で協議を行う</p> | <p>残置/切替とその判断に付随する議論は当事者間で協議 QCDの判断のためにOEMは台数提示に努める</p> |

OEM 14社との意見交換

社内確認状況共有

- ・調達部会および事務局様を通じてガイドラインに対しての項目確認いただいている
- ・特に流用に関して課題のあるOEM様多い

今後の進め方(個社)

- ・流用に関する運営トライ
- ・社内Prjによる議論
- ・自工会ガイドラインの活用による社内普及活動
- ・他社事例の共有による社内活動の加速

今後の進め方(半導体WG)

- ・半導体WGでの取り組み事例提示共有
- ・勉強会の設定

データPFとの連携

- ・DX活用による早期連携についての期待
- ・非推奨フラグの活用によるTier1との連携きっかけづくり(Tier1からの打上げ待ちからの転換)

その他

- ・苦労した経験者のいる間にやり切り

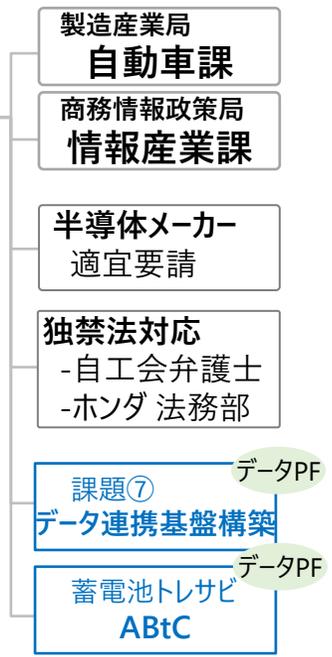
新陳代謝の促進に向けた部工会ガイドライン、業務フロー

部工会 半導体WG

2025年度 半導体WG体制

日本自動車部品工業会

日本自動車工業会



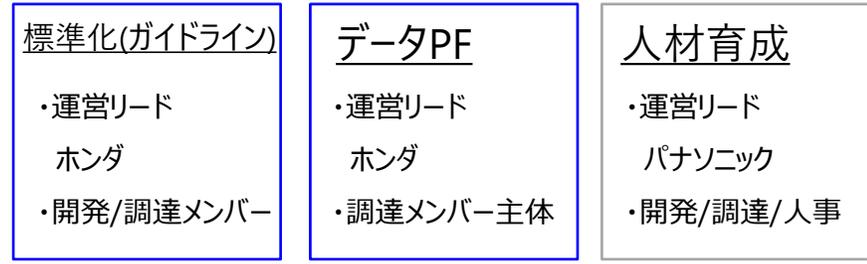
●全体ワーキング Lead：ホンダ

チーム編成・検討アイテム提示
↑全体ワーキングへのレポート

- ・小集団活動に対する確認
- ・方向性議論、各社意思整合
- ・関連団体/企業との連携確認
(JAMA内・JAPIA・経産省etc)
- ・適法性確認
- ・自工会内報告対応確認

●小集団ワーキング

課題・施策検討を小集団でスピード感ある運営



目指す姿とガイドラインを通じた取り組み

■ 目指す姿

- ・旧型品の新陳代謝の促進による安定供給
- ・自動車業界としてEOL対応(切替/残置)の環境整備

【参考】半導体業界と日系自動車業界の商習慣ギャップ

| | |
|-----------|------------------|
| 製品ライフサイクル | |
| 半導体業界 | 最新技術を迅速に市場投入 |
| 自動車業界 | 長期間同じモノを使用 |
| 業界間ギャップ | 旧型品長期使用 |
| 欧米自動車業界対応 | 古いものは切替、EOLは一括購入 |

■ ガイドラインを通じた取り組み

< 現状 >

- ・車両量産期間が不明・長期化
- ・残置/切替や費用負担に関する協議のハードルが高い
- ・切替のハードルが高い、工数が大きい

< 自工会ガイドラインの観点 >

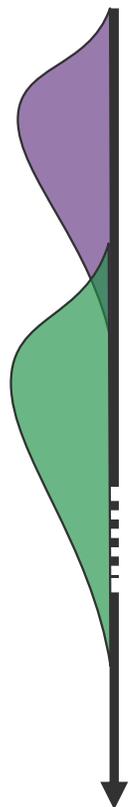
- ・OEMは企画モデルライフ/企画台数を提示する
- ・OEMはECUのキャリー情報をTier1へ通知する
- ・想定より長期生産する車種はOEM/Tier1でリスクを協議、残置/切替の判断、費用負担を当事者間で協議

< Tier1の取り組み >

- ・OEMから提示される情報に基づき、旧型品を新陳代謝することで、安定供給につなげる

旧型品の新陳代謝に向けたTier1の実施事項

半導体部品



新規車種

供給期間不明

Before(現在)



After(ガイドライン発行後)



後続車種

想定外の需要

Tier1に通知せずASSY横展開



Tier1にASSY展開を通知



長寿命車種

リスク予防未実施

リスク協議なし



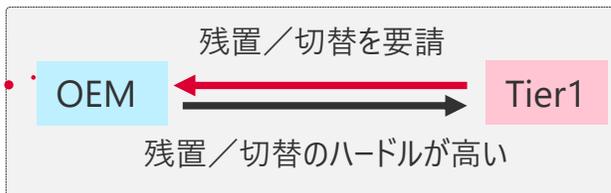
定期リスク共有



EOL

供給側の責任大

残置/切替を要請



残置/切替を要請



Tier1の実施事項

- OEMのモデルライフ期間に対し、供給期間を回答
- 回答した供給期間内での安定供給
- 部品のEOLリスクの情報収集とOEMとの共有

ガイドライン実行に向けたTier1の取り組みのモデルとなる、業務フローも共有

自工会ガイドライン、部工会ガイドライン案

OEM

ガイドライン

努力目標

①【部品新規開発の場合】
電子電装部品の新規開発時において、Tier1にて供給性を確保した製品選定ができるように、RFQに必要な情報を明示する

※なお、10年を超えるような長期車両、かつモデルチェンジなどのイベントの計画がない車両の場合は定期的に供給性を確認するマイルストーンを設ける

②【部品流用の場合】
既存の電子電装部品の流用時において、各OEMで当該部品の車両展開情報を可能な限り正確に、かつ迅速に通知する

※なお、10年を超えるような長期車両、かつモデルチェンジなどのイベントの計画がない車両の場合は定期的に供給性を確認するマイルストーンを設ける
※提示方法についてはRFQに限らず個社運用に沿って対応

③【車両生産延長の場合】
①、②で提示した企画モデルライフよりも長期に生産する車両において、生産延長が判明した段階で迅速に通知する

上記①～③を踏まえ、供給継続に懸念が発生する場合において、Tier1とOEMで密にコミュニケーションを取り、QCD等も考慮の上、対応については当事者間で協議を行う

下記情報例の提示に努める
a) 該当PJT(車両)の量産開始時期
b) 該当PJT(車両)の企画モデルライフ
c) 該当PJT(車両)の企画台数
※企画モデルライフは企画時の償却想定期間で、生産期間ではありません
※企画モデルライフと生産想定期間が異なる場合は別途通知を行う

下記情報例の提示に努める
a) 電子電装部品が展開される先の該当PJT(車両)の量産開始時期
b) 該当PJT(車両)の企画モデルライフ
c) 該当PJT(車両)の企画台数
※企画モデルライフは企画時の償却想定期間で、生産期間ではありません
※企画モデルライフと生産想定期間が異なる場合は別途通知を行う

下記情報例の提示に努める
・EOP/モデルチェンジの時期情報
(EOP/モデルチェンジが未定の場合は、その旨通知)

残置/切替とその判断に付随する議論は当事者間で協議
QCDの判断のためにOEMは台数提示に努める

Tier1

ガイドライン

努力目標

①【部品新規開発の場合】
RFQの情報をもとに、電子電装部品の供給性(EOLリスク、キャパシティ)を確認し、供給継続性の高い部品を選定することに努める

②【部品流用の場合】
OEMからの情報をもとに、電子電装部品の供給性(EOLリスク、キャパシティ)を確認し、問題有無をOEMに通知する

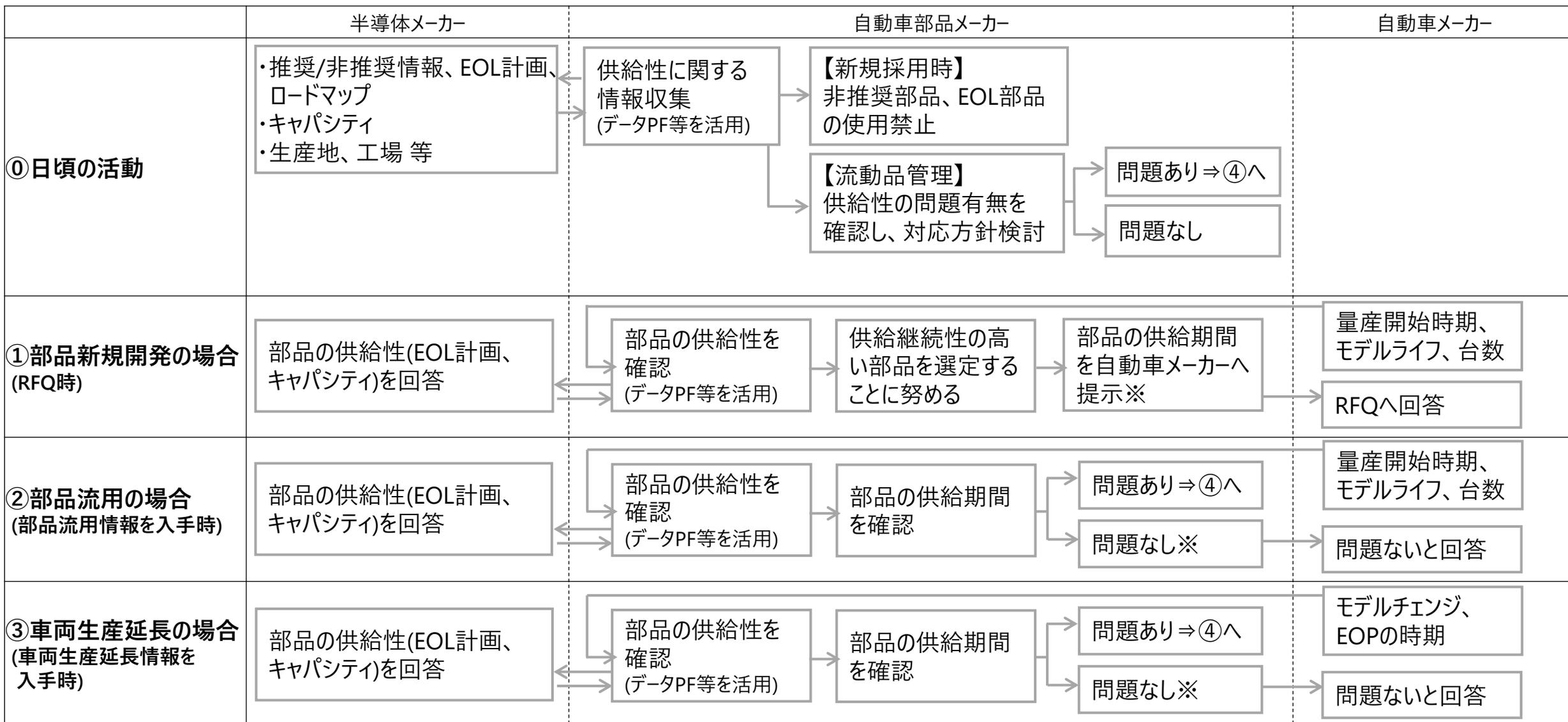
③【車両生産延長の場合】
OEMからの情報をもとに、電子電装部品の供給性(EOLリスク、キャパシティ)を確認し、問題有無をOEMに通知する

上記①～③を踏まえ、供給継続に懸念が発生する場合において、OEMと密にコミュニケーションを取り、QCD等も考慮の上、サプライチェーンの維持に向けた方策について当事者間で協議を行う

下記の主体的な活動推進に努める
・平時より使用部品の供給性を確認/管理する
・リスク部品を採用せざるを得ない場合、供給リスクについてOEMと協議する

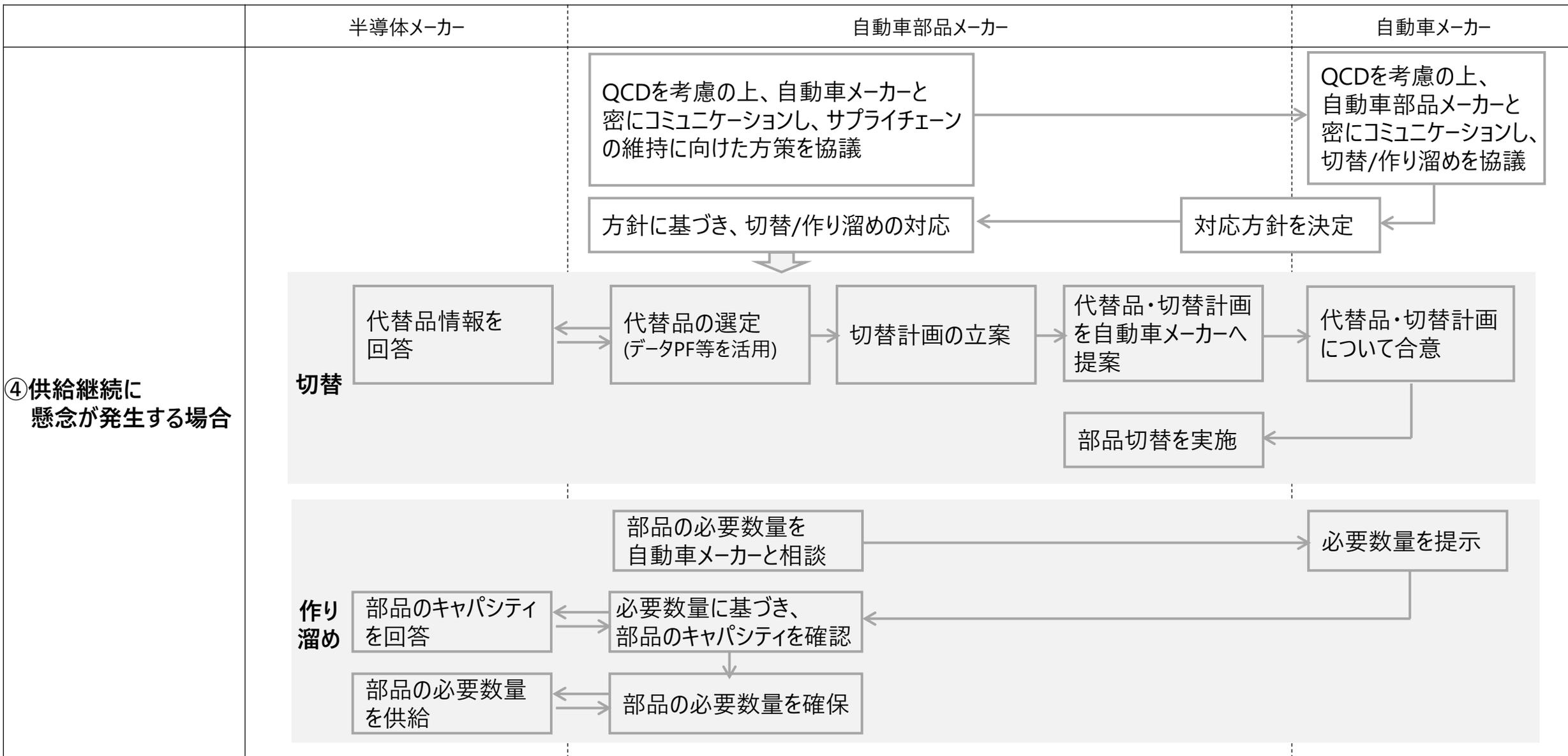
下記の主体的な活動推進に努める
・代替品、代替品切替計画等のバックアップ策を提示する
・作り溜め選択時はOEMと合意した必要数量を確保し、量産終了までの環境変化への対策は都度OEMと協議する

部工会ガイドラインの実行に向けた、モデルケースとしての業務フロー



※調査時点の情報に基づき回答

部工会ガイドラインの実行に向けた、モデルケースとしての業務フロー



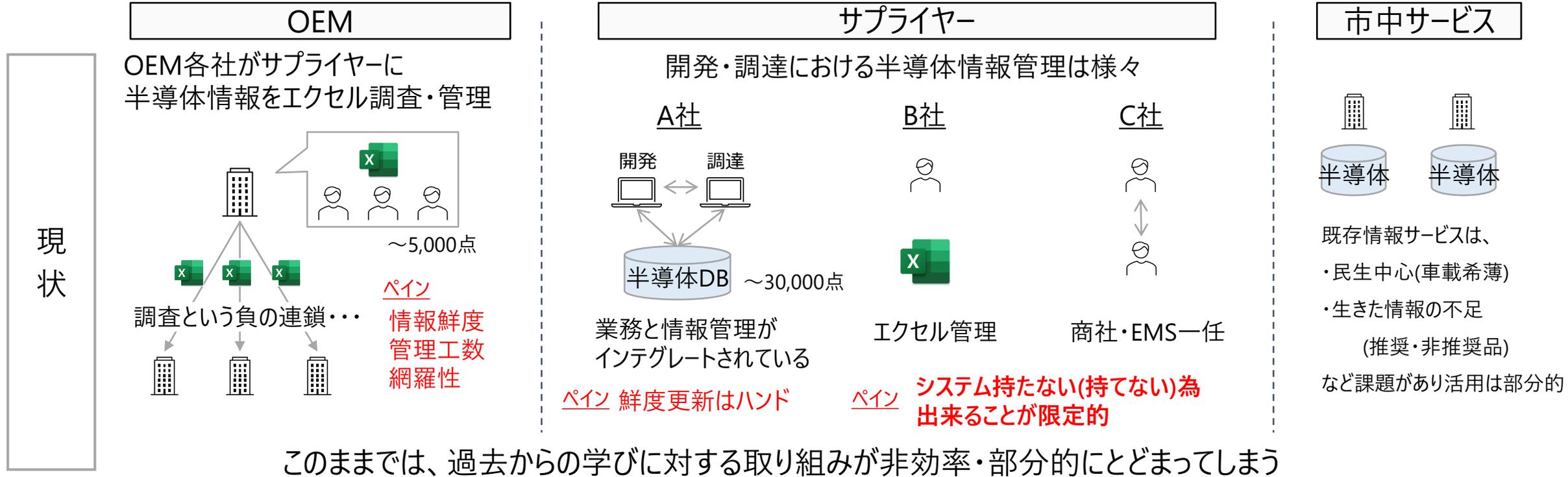
車載半導体データPF

自工会 半導体WG

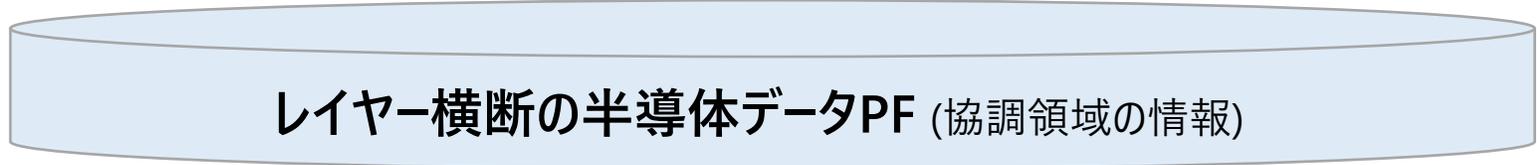
課題③ 半導体安定調達 車載半導体の情報管理現状

クルマ1台に約700~1000点を搭載している半導体の情報管理イメージ (生産地・製品技術情報etc)

※最低限必要なBOM・受発注システム等は除く



変革のアイデア



標準化やBCP対策を支える半導体の情報基盤を持つことで、業界全体のECM/SCM体質を底上げしたい

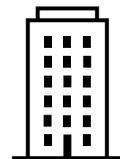
運用の悩みや、活動の温度差、レイヤー間の情報の壁がはだかり、プロセスの改革が産業全体で進まない恐れ

車載半導体データPF構想 (案)

- ・背景 : クライシス後、サプライチェーン安定化を目指し、OEM・Tier1が各社各様に半導体情報を集める動きが加速
- ・狙い : 新陳代謝促進や安定調達・BCPに必要な“情報の協調領域”を定め、データプラットフォーム化することで業界間を繋ぐ

- ・アクセス管理
- ・運営費収支管理 (維持運用+サービス費)
- ・情報セキュリティ担保

車載半導体
データサービス



- ・登録促進 / 維持管理
- ・運営費収支管理 (維持運用費)
- ・情報セキュリティ担保

■データPF化する情報(案)

| 大分類 | 中分類 | 小分類 |
|------------------|---------|----------------------------|
| 基本情報 | 製品情報 | 半導体型番 |
| | | 半導体メーカー名 |
| | | 半導体分類 (JEITA準拠) |
| | スペック | 製品スペック情報 (データシート) |
| レガシーリスク | ライフサイクル | SOPタイミング *1 EOLタイミング *2 |
| | 仕様 | プロセスノード[nm] ウェハサイズ[mm] |
| 地政学リスク ・BCP対応 | 生産地 | 前工程：メーカー名/所在地 |
| | | 後工程：メーカー名/所在地 |
| | | 検査工程：メーカー名/所在地 |
| | BCP | 代替有無 / 有の場合IC型式 |
| 標準化 新陳代謝促進 | 推奨リスト | 推奨品フラグ |
| | | 非推奨品フラグ |

安定調達に必要な情報を取得
(EOLリスク低減・BCP情報)

新陳代謝促進に必要な情報を
全体展開できるメリット

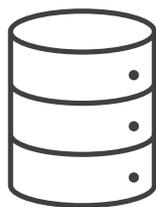
車載半導体関連
情報取得

車載半導体関連
情報提供

- ・SC基本情報
- ・推奨/非推奨

- ・SC基本情報
- ・推奨/非推奨

車載半導体
データPF



情報利用者 (部品メーカー・OEM)

半導体メーカー



*1 SOP : Start Of Production / *2 EOL : End Of Life

車載半導体データが核となり、作る側(半導体)・買う側(自動車産業)を繋ぐことで、プロセス変革を広く推し進めたい
「専門家を交えた実現手法の検討の深化と加速」「参加企業の拡大」が課題

当日投影のみ

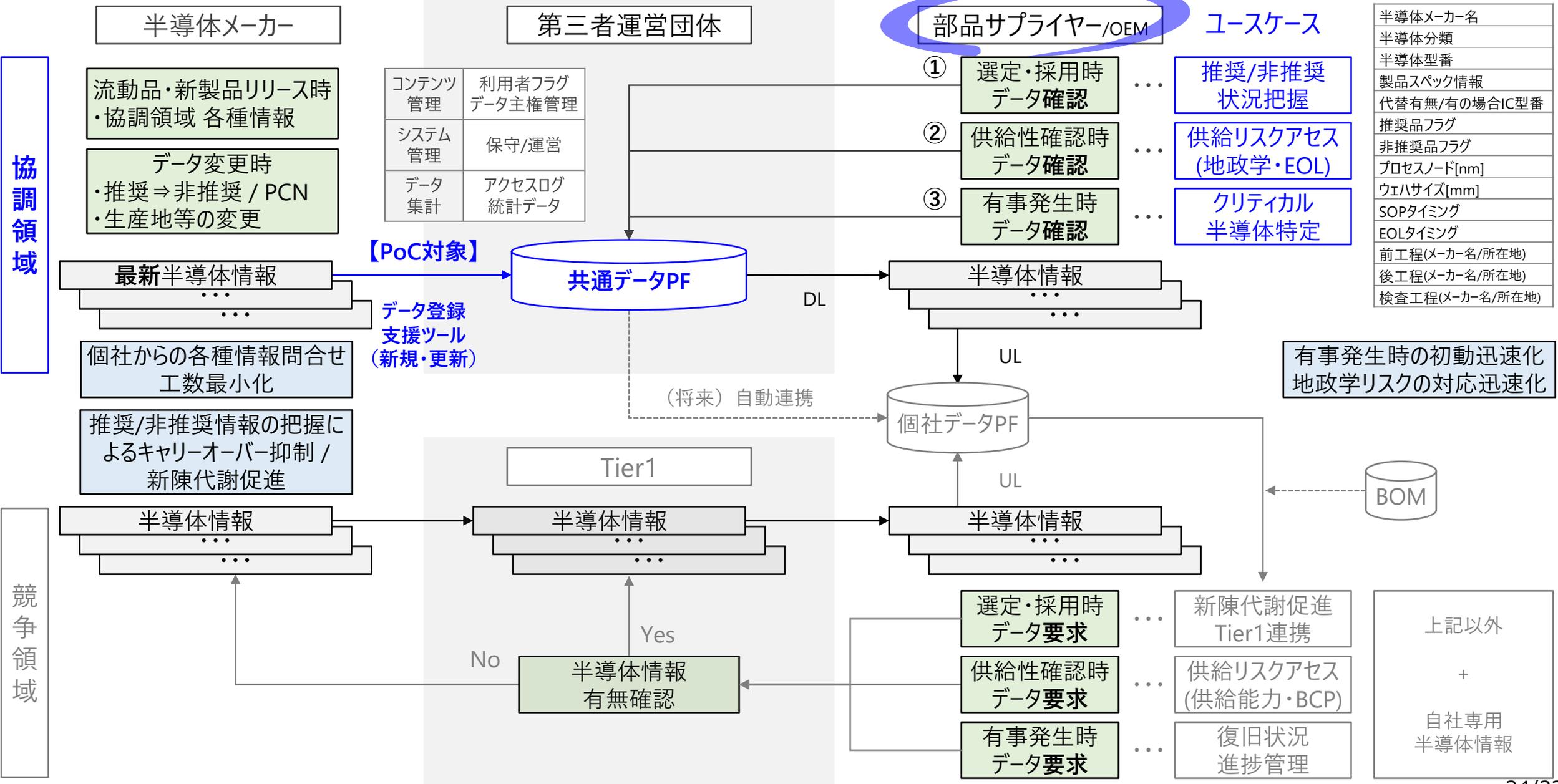
想定ユースケース

凡例

データ

イベント

メリット



| |
|-----------------|
| 半導体メーカー名 |
| 半導体分類 |
| 半導体型番 |
| 製品スペック情報 |
| 代替有無/有の場合IC型番 |
| 推奨品フラグ |
| 非推奨品フラグ |
| プロセスノード[nm] |
| ウェハサイズ[mm] |
| SOPタイミング |
| EOLタイミング |
| 前工程(メーカー名/所在地) |
| 後工程(メーカー名/所在地) |
| 検査工程(メーカー名/所在地) |

有事発生時の初動迅速化
地政学リスクの対応迅速化



上記以外
+
自社専用
半導体情報

本日のお願い事項

自工会/部工会 半導体WG

本日のお願い事項

■お願い事項

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | 新陳代謝の促進に向けたガイドライン | モデルケースとしての業務フローも参考いただき、各社にて、新陳代謝の促進に向けた業務設計と活動推進をお願いします |
| 2 | 車載半導体データPF | 今後開催予定の説明会へご参加いただき、車載半導体データPFの活用をご検討ください |
| 3 | 今回の説明会に対するフィードバック | 説明会のZoom終了後、アンケート回答をお願いします |

■今後の対応

- ・各社の取り組み状況、困りごと等について把握するため、今回の説明会への参加企業の方は、定期的にアンケートへのご協力をお願いいたします
- ・車載半導体データPFの詳細につきましては、26年2月頃に説明会を開催予定です

上記、半導体供給に関する将来リスクのミニマム化のために、2つの活動へのご協力をお願いしたい

Q&A (よくある質問集)

自工会/部工会 半導体WG

| | 項目 | 質問 | 回答 |
|----|--------------|---------------------------|--|
| 1 | 対象 | ガイドラインにある電子電装部品とは何か | コロナ禍における供給課題の背景を踏まえ、車載半導体および受動部品を想定している。 |
| 2 | ライフ・台数提示 | OEM提示のライフ・台数情報の内容は | OEMが計画する車両の償却想定期間であり、台数は将来の計画台数となる。 |
| 3 | 情報共有の頻度 | OEMがライフ・台数情報を提示する頻度・時期は | 各OEMの計画台数決定タイミングなどの管理共有は独禁法遵法の観点から行っていない。運用自体はOEM個社判断となるが6ヶ月～1年が想定される。 |
| 4 | 各OEMの共有方法 | どのような形式でOEMから情報共有されるのか | 各OEMのシステム状況や運用状況で異なるが、当面は、エクセルやテキスト形式で月割り/年割の形式を想定している。 |
| 5 | ガイドラインの強制度 | ガイドラインは強制なのか | 独禁法を踏まえれば、ガイドラインを強制することはできないが、ガイドライン公表を行っていくことで、将来の半導体課題を踏まえて本活動がより実効性のあるものになっていくことを期待している。 |
| 6 | ガイドラインの運用時期 | 9月発信予定とのことだが、運用開始はいつなのか | 各OEMのシステムあるいは業務プロセスへの準備状況によりタイミングは異なる。9月の発信以降も各社の課題解決を進めていきたい。 |
| 7 | 保守部品・補給部品 | 作り溜め時、保守・補給部品も数量提示されるか | ガイドラインの4項の通り、作り溜めにおける議論についても対象としている。 |
| 8 | 協議 | 切替/作り溜めについて、公平な協議がされるか | 取引関係の中で十分に協議いただくことと理解している。現在自工会では適正取引に関する自主行動計画の方針に沿った対応に努めており、一例として「1. 合理的な価格決定」の中で「取引先との価格決定に当たっては、運用基準、振興基準等を踏まえ、取引数量、納期、品質、環境対応等の条件等を考慮し、取引先と十分に協議を行う」こととしている。 |
| 9 | 作り溜め | OEMから数量提示いただけるか | ガイドラインの4項の通り、作り溜めにおける議論についても対象としている。 |
| 10 | 費用協議 | 発生する費用についてOEMと公平な協議ができるか | 費用に関する協議等は、取適法や適正取引に向けた自主行動計画に沿った行動に努めたい。 |
| 11 | 切替承認の効率化、簡素化 | 切替承認を効率化・簡素化する検討はしないのか | 工程変更(製造工程・材料変更)については標準化のガイドライン(JASO-TP)を作成済み。EOLでの代替設計での変化点は様々なパターンがあり標準化は難しいため、新陳代謝を促進し、EOLにならない取り組みが重要。EOLについてもガイドライン化できないか自動車技術会(自技会)にて検討中。 |
| | | 切替に時間を要するためOEM窓口を統一化できないか | 自工会活動の中で各OEMの体制については独禁法遵法の観点から共有を行っていない。切替時間の問題については全体を俯瞰して自工会としてできることを検討したい。 |
| 12 | 海外分の対応 | 安定供給のため海外分の対応も必要ではないか | 網羅的な課題解決には、海外拠点を含めた取り組みの必要性は自工会・部工会内でも認識しており、各社の組織/役割に応じた展開の仕方を各社毎に検討していく |

| | 項目 | 質問 | 回答 |
|----|-------------|----------------------------|---|
| 1 | 対象 | 車載半導体とは何が対象か | 車載半導体全般とするが、対象データは協調領域であることを考慮すると、ASIC等のカスタム品は対象範囲外となる見込みである。 |
| | | 電気部品は対象ではないのか | 将来的には新陳代謝促進の対象となり得るものの、来春の運用開始時点では対象範囲に含めない見通しである。 |
| 2 | 半導体メーカー | データPFに参画する半導体メーカーは | まずは来春の運用開始に向け、アナログ、パワー、MCU等の車載半導体における主要半導体メーカー20社に対して参画を呼び掛けている。 |
| | | データPFに参画する半導体メーカーは今後拡大するのか | 持続的な運用メリット創出に向け、運用開始後も引き続き参画拡大に取り組んでいく。 |
| 3 | 情報の鮮度 | 情報の鮮度が重要だが更新頻度はどうなるのか | 半導体種類によって更新頻度も異なり、かつ情報提供者側のデータ更新方法にも依るところが大きいことから、現在、PoCを通じて実行課題を洗い出している状況ではあるものの、例えば月1回の更新といったシンプルな運用を想定している。 |
| 4 | 推奨/非推奨情報 | 推奨/非推奨情報の定義は | 新陳代謝の促進に向け、情報提供者側の自社基準に則って提示いただく。 |
| 5 | Tier1の利用ケース | Tier1が利用するケースは、利用メリットは | 推奨/非推奨状況の適時把握や地政学やEOLなどの供給リスクアセスメントに加え、有事発生時にはクリティカル半導体を迅速に特定できる等オペレーションコストの削減が期待される。 |
| 6 | OEMの利用ケース | OEMが利用するケースは、利用メリットは | 上記と同様の利用メリットを想定している。 |
| 7 | 利用料金 | 利用料金はいくらか | 業界協調で進める事務局費用などの基本料金と、享受するメリットに応じた従量課金を理想としているが、運用メリット(新陳代謝促進やオペレーションコスト低下等)の定量化の困難度に加え、利用料金が参画維持・拡大の障壁とならぬよう配慮しつつ、来春の運用開始に向けて継続検討していく。 |
| 8 | 利用企業 | OEM、Tier1はどれくらいの企業が利用するのか | OEMは自工会14社、Tier1は最終的に100～150社程度を目標としている。 |
| 9 | データPFの強制度 | データPFへの参加は強制なのか | 関連する法規制は存在しないため、強制とはならない。 |
| 10 | 運営 | 第三者団体を設置する理由は | 公益性といった観点の中でも、特に情報提供元となる半導体メーカーにとっての情報セキュリティ(安全性・信頼性・中立性)の担保が必要であると判断したためである。 |
| | | 経産省との関連は | 半導体等の自動車部品SCのデータ連携基盤構築に向けた実証事業として展開中。 |
| 11 | 情報管理 | 個社の半導体情報はどのように管理されるか | ウラノス・エコシステムとしてデータ主権規則に準拠した対応を考えている。 |

【質疑応答】

Zoom機能で「**挙手**」、企業名、お名前をご紹介いただき、
ご質問をお願いします。

また、以下のどちらに関する質問かを明確にした上でお願いします。

- 自工会ガイドライン
- 部工会ガイドラインと業務フロー
- 車載半導体データPF
- その他

なお、時間の関係上、すべてのご質問に
回答できない場合がありますので、予めご容赦ください。

ご静聴いただき、ありがとうございました。

本日の説明会に関するアンケートへのご協力をお願いします。
(本Zoom終了後、自動的にMicrosoft Formsが立ち上がります)

【自工会・部工会共催】(8/27) 車載
半導体の安定調達に向けた取り組みに
関する説明会 アンケート調査 ご協力の



<本件に関する問い合わせ>

【自工会 会員企業】

自工会事務局（井上）までご連絡願います。

【部工会 会員企業】

一般社団法人日本自動車部品工業会 業務部 伊藤、田中、尾関
E-mail : gyoumu@japia.or.jp TEL : 03-3445-4214 (業務部)

END